

北京信息科技大学

教师岗位 2013 年度工作考核及首次全员聘任聘期考核表

单 位	信息与通信工程学院	姓 名	缪 旻	出生年月	1973.11
现技术职务	副教授			任职时间	2008.01
2013 年度工作考核内容					
2013 年度工作总结	2013 年，本人按照学校的各项规章制度严格自律，积极进取，在领导的关怀和同志们的帮助下，取得了出色的成绩，现按以下方面进行述职： 品德：本人政治立场坚定，热爱党、热爱人民，积极提高自己的政治思想水平。自己在工作始终以党员的先进性和党的干部的标准严格要求自己，把政治思想学习与岗位工作紧密联系起来。严守党的纪律，认真履行岗位职责，严守岗位行为规范；平时注意职业道德修养，加强师德建设，并积极在教学中注意了解学生的思想动向，在传授专业知识的同时弘扬主旋律，把思想教育融入专业技术知识的教育中；本人廉洁自律，注意与其他同志的团结协作，积极认真参加专业学科建设，积极参与集体组织的公益、学习和文体活动，乐于助人，与同事关系融洽。作为教工党支部书记，认真执行好学校党委和总支的各项工作部署，努力提升自身修养和思想理论水平，热心服务师生，带领全支部完成好争先创优和建设“五好”支部，成为群众满意度高的、坚强的基层战斗堡垒。 能力：本人在教学实践中注意总结和学习，努力提高教学水平，积极开展教学改革和建设工 作，较好地完成了饱满的教学任务，撰写出相应的主干课程辅导材料和教科书初稿。本人认真把握本领域技术发展前沿及动向，在工作中注意发扬创新精神，努力开拓新的研究领域，在承担的项目数量、层次和成果方面有较大的进步。 知识：本人勤奋敬业，通过自学和参加北京大学研讨班、ECTC Short Course 等各项培训，提高自己科研技能、创新能力和科研管理能力。 业绩：本人承担了 2 门本科生专业主干课和 1 门选修课以及 2 门研究生学位课的教学任务，学生反映良好，教学综合评价为优。完成教改项目 1 项，参与院级教学研讨会 3 次。参与所在专业的专业建设和实验室建设。本人积极开展科研工作，作为课题负责人承担国家自然科学基金面上项目 1 项、GF 973 项目二级子课题 2 项、国家科技重大专项子课题 2 项（新增经费 55 万元）、司局级项目 1 项，横向经费新增 10 万元。作为第一作者发表相关领域顶级国际会议 1 篇，EI 收录的核心期刊论文 1 篇，作为第二作者指导研究生发表论文 2 篇。作为第一译者翻译学术专著 2 部，其中一部已由机械工业出版社出版。作为封面第二作者出版中科院科学出版基金资助的学术专著一本（科学出版社，2014 年 1 月出版，已收到样书）。所带领的科研团队成为华进半导体先进封装中心（国家级工程中心）高校团队成员（其他团队都是 985 高校），落实来自 02 专项的课题经费 90 万元。担任国家自然科学基金、黑龙江自然科学基金函审专家；JMAPs 等国内外 EI 学报审稿人。获得国家发明专利授权 1 项、软件著作权 1 项。				
进修培训情况	1. 参加国际顶级会议 ECTC 的 Short Course，计 8 个学时。 2. 参加北京大学 2013 年度“三维微系统设计及集成”研修班，共计 16 周（4 学时/周），听课并参与讨论发言 3 次。 3. 自修外语、计算机和微波天线、信号完整性等新的专业知识和技能。 4. 参加中国电子质量管理学会 2013 年“微系统集成与封装技术”高级研修班，共计 3 周，24 个学时。				

教 学 工 作	课程, 教改论文、项目名称	授课对象、刊物名称(发表时间)、项目角色(主持/参加)	授课时数、刊号、项目来源
	1.电磁场与电磁波(必修) 2.电磁场与电磁波(必修) 3.微电子学基础(选修) 4.高等工程电磁场(研究生学位课) 5.专业英语(研究生学位课) 4.“电磁场与电磁波”课程学科前沿与教学内容有机结合的研究与实践 5.电磁场与电磁波	通信 1102~1105, 计 4 个班。 数理实验班, 1101~1102, 计 7 人。 通信 1101~1105, 计 5 个班, 58 人。 研 1305 班, 17 人 研 1205、1214 班, 22 人 角色: 主持 角色: 支持	授课 56 学时。 授课 56 学时 授课 32 学时 授课 32 学时 授课 32 学时 校级教改项目 校级教材建设项目
科 研 业 绩	科技论著、项目名称	刊物名称(发表时间) 项目角色(主持/参加)	刊号、项目来源
	1.60GHz 贴片天线用低温共烧陶瓷基板的微机械加工 2. Investigation of Micromachined LTCC Functional Modules for High-density 3D SIP based on LTCC Packaging Platform 3. Hollow TSV VS Solid TSV and Effect of Medium Filling in the Hollow TSV 4. Software Design On TSV-Based Three-Dimensional Interconnected 5. Electrical characterization of integrated passive devices using thin film technology for 3D integration 6. 三维集成电路设计 7.“电磁模型” 8.“三维互连测试” 9. LTCC 微加速度计 10. 人才强教深化计划 11. 面向物联网的微系统电互联设计技术 12. TSV 转接板电特性研究 13. 多功能 LTCC 基板微功能结构设计与分析 14. 基于 MEMS 的微系统技术	光学精密工程(2013.6), 第 1 作者 the 63nd Electronic Components and Technology Conference (ECTC), Las Vegas, Nevada, 第 1 作者, 5 月 14th International Conference on Electronic Packaging Technology (ICEPT), 第 2(通信)作者, 8 月 14th International Conference on Electronic Packaging Technology (ICEPT), 第 2(通信)作者, 8 月 Journal of Zhejiang University SCIENCE C, 第 7 作者, 6 月 2013.09, 封面第一作者 主持 主持 主持 主持 主持 主持 主持 主持	CN22-1198/TH, EI、核心 EI 收录 EI 收录 EI 收录 SCI 收录 ISBN: 978-7-111-43351-4 973 二级子课题 973 二级子课题 国家自然科学基金面上项目 北京市教委 横向 横向 横向 横向
奖 惩 情 况	2013 年度信息与通信工程学院“科研先进个人”。		
部 门 考 核 意 见	考核等次: _____ 负责人签字: _____ (公章) _____ 年 月 日		

聘 期 考 核 内 容

聘 期 学 术 工 作 总 结

本聘期（2011.5.24~2013.12.31）内，在专业理论知识、技术的学习方面，通过积极参加北京大学等知名高校开设的前沿研讨班（共计 2 次）、在职进修活动和 IEEE 学会等国际著名学术、科研机构举办的、由国外专家主讲的讲座、Workshop 或 Short Course（共计 10 次，每次 8 学时），以及坚持不懈的自修学习，不断深化、拓展自己的专业知识，提高自己的专业、学术素养。

在学术工作中坚持求实创新和严谨的学风，并以此要求自己的科研团队和所指导的研究生。本聘期内的学术工作分述如下。

1. 作为主持人或者骨干已承担了多项国家级和省部级项目。具体情况是：

1) 作为子课题负责人，以我校为依托单位，承担国家 973 计划项目，目前已有 25 万元拨付我校，30 万元即将拨付到账，我校合同总金额达到 100 万元。；

2) 作为课题负责人承担的国家自然科学基金课题一项，“嵌入低温共烧陶瓷多层封装基板的微机械太赫兹波导、波导元件及其工艺研究”，编号 60976083，目前已结题；

3) 作为课题负责人承担国家自然科学基金课题一项“LTCC 微加速度计”，编号 61176102，目前进展顺利。

4) 作为课题负责人承担北京市自然科学基金课题一项“系统级封装多层基板中冷却用微管道网络的微制造技术”，编号：3102014，目前通过结题验收。

5) 作为课题负责人承担北京市属高等学校人才强教深化计划“中青年骨干人才培养计划”项目“三维系统级封装（3D SIP）设计技术基础研究”一项，目前进展顺利。

6) 国家科技重大专项项目子课题两项：a) 系统级封装内立体互连电性能协同设计/仿真及封装电特性仿真，隶属 02 专项“高密度三维系统级封装的关键技术研究”（2009ZX02038）课题一，总经费 240 万；b) 晶圆深孔加工工艺研究，隶属 02 专项“高密度三维系统级封装的关键技术研究”（2009ZX02038）课题二，总经费 410 万。本人依托北京大学承担该两项子课题。目前该项目正在进行由科技部和 02 专项专家组的验收。（相关情况见项目牵头单位中科院微电子所开具的证明材料）

7) 作为课题负责人，承担物联网、微纳系统集成方向的横向课题 5 项，均已结题，到账金额在 50 万元以上。

8) 依托北京大学，作为项目负责人承担武器装备重点预研项目 1 项（十二五，总经费 330.00 万元），预研基金项目 2 项。作为排名第 2、第 3 的骨干承担探索项目（总经费 200.00 万元）和十一五重点预研项目一项。

9) 作为项目负责人承担北京市科研基地建设项目两项，经费为 59.00 万元（2013），已完成建设。

上述项目研究进展顺利或者按时结题，并形成了论文、专著、专利等丰富的学术成果。经费到账总额在 150 万元以上。

2. 积极争取国家级、省部级科研计划项目的支持，参与国家产业攻关和联合创新计划，拓宽研究方向和经费渠道，实现科研水平的大幅跃升。

积极努力，作为负责人新落实的相关重点或重大课题包括

1) 本人任所长的信息微系统研究所已受聘为华进半导体封装先导技术研发中心（即国家先进封装工程化中心，2012 年 9 月由国务院批准正式成立，系国务院直管单位）高校研发团队（由来自 16 所 985 高校或中科院的团队以及我校组成）之一。本人在带领团队深度参与该中心的研发同时，担任高校顾问委员会成员。目前已落实华进半导体封装先导技术中心承研的 02 专项项目子课题，合同金额为 90 万元。

2) 积极与华为、江阴长电、中芯国际、北京索为等国家行业龙头企业合作，承担企业委托的产业化攻关或者前瞻技术研究课题多项，其工作得到企业的好评。

3. 科研团队、科研环境建设，研究生指导情况

通过努力，初步创建了一只精干、高效的科研团队，在学校支持下，所成立的“信息微系统研究所”的科研硬件条件得到不断充实和提高，目前设备总资产原值达到 180 万以上，为项目研究提供了有力支持，为本单位和外单位提供多次测试服务。

吸收本专业教研室的 3 名中青年教师作为骨干参与自己的科研团队，帮助其提高科研技能、学术水平；任现职以来在微系统封装、微波功率放大器等方面进一步拓展了自己的研究方向，与国内外的著名高校、科研院所（UCLA、UC Berkeley, GeorgiaTech, IBM TJ Watson Center）建立了稳定合作关系。

作为硕士导师指导我校硕士研究生 9 名，协助指导 3 名。参与指导了来自北京大学的 4 名博士、5 名硕士研究生。

4. 学科建设

作为我校承担的北京市重点学科“信号与信息处理”学科“通信信号处理”方向的学科骨干，积极开拓本学科新的研究领域，目前所在信息微系统、微/纳米微波新器件、先进封装/高速信号完整性以及物联网基础工程等方面开展了研究，注重把科研和教改联系起来，不断提高自己所承担的研究生主干课程和选修课程的教学水平，丰富了教学内容。作为骨干和方向带头人积极参与新的二级学科硕士点“电子与通信工程”、“通信与信息系统”申报，并获批。作为主要骨干参与二级学科“智慧感知”申报，并获批。

5. 论文发表、专著编著、专利/知识产权

本聘期国际会议和学报上发表了较高水平的论文，赴美国口头宣读论文 1 篇次，作为第一作者在国际会议上发表论文 12 篇（包括研究生第一作者，本人第二作者），其中包括 10 篇论文已经被 EI 检索，而且所有国际会议论文均被 IEEE 论文全文库收录。

2012 年，作为封面第三作者在国防工业出版社出版微纳米技术专著一本，获得国家科学技术学术著作出版基金这一国家最高出版基金和国防科技出版基金双重资助

作为第一译著翻译本专业方向重要技术专著两部，两部均已与机械工业出版社签订合同，其中一部于今年 9 月正式出版，另一部已交稿；作为第二作者撰写专著一部（已经与科学出版社签订合同并交稿，2014 年 1 月出版，已取到样书）。

作为第一发明人、申请国家发明专利 4 项，获授权 3 项。获得软件著作权登记 2 项。

6. 参与学术公益工作

- 1) 长期担任北京大学微米/纳米加工技术国家级重点实验室客座副教授；
- 2) 被遴选为两个专业国际会议（ICEPT, IEEE NEMS）的分会主席；
- 3) 中国微米/纳米技术学会高级会员（2006~）；
- 4) 国家自然科学基金委通信评审专家（2006~）；
- 5) 黑龙江省自然科学基金通信评审专家；
- 6) 总装预研基金通信评审专家（2006~）；
- 7) 中关村东升科技园专家库成员（2012~）。
- 8) 半导体学报（EI 核心期刊）审稿人（2012~）
- 9) IEEE 会员，会员号：92658027，CPMT 和 Communication Society 等分会会员。
- 10) 美国 International Microelectronics And Packaging Society（IMAPS 学会）的 The Microelectronics Journal of Microelectronics and Electronic Packaging 期刊审稿人。
- 11) 作为技术委员会成员组织在美国召开的 IEEE CPCW 研讨会两次（2011.09, 2012.10）。

7. 国际合作与交流情况

积极与国外研究机构建立了科研合作关系，其中与北京大学合作承担 Samsung 公司项目一项。与 UCLA、UC Berkeley, IBM T.J. Watson Research Center 建立合作关系，定期访问上述机构。

8. 大学生科技创新和相应的高等教育研究情况

2011~2013 年度吸收 4 届本科生共计 10 人，参与自己负责的前沿性国家级和省部级课题多项的研究，每人参与研究的时间为三年级~四年级（包括毕设）。其中 2 名本科生取得了突出的创新性成果，作为发明人和作者分别申请专利一项，发表核心期刊论文和国际会议各一篇。

教 学 工 作	岗位说明书规定的教学工作任务及工作量	聘期内完成情况（可另附页） 课程名称、授课对象、授课时数；指导学生情况；教研、教改项目、课程建设；教材、教学成果奖励、教研、教改论文（只写第一作者）等																															
	1、每年主讲本科课程 2 门次（含）以上，每年指导本科生毕业设计或承担其它实践性教学环节的指导工作，教学效果优良，年教学工作量达到所在院系规定的标准； 2、硕士生导师在聘期内招收指导硕士研究生不少于 2 人； 3、积极承担研究生、本科生的学术讲座、学科竞赛指导、学生课外科技活动指导、学科专业教育等工作。	1.教学工作量、指导本科生毕设等实践环节。																															
		本科生教学工作量																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>授课时间</th> <th>课程名称或其它教学任务</th> <th>授课对象及人数</th> <th>总学时</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011~2012 学年第 2 学期</td> <td>电磁场与电磁波（专业主干）</td> <td>通信 1001~1004, 114 人</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>2012~2013 学年第 1 学期</td> <td>微电子学基础（专业任选）</td> <td>通信 0901~0904, 81 人</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>2012~2013 学年第 1 学期</td> <td>天线与电波传播（专业必修）</td> <td>通信 0801~0804, 122 人</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>2012~2013 学年第 2 学期</td> <td>电磁场与电磁波（专业主干）</td> <td>数理实验班 1001~1004, 7 人</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>2013~2014 学年第 1 学期</td> <td>电磁场与电磁波（专业主干）</td> <td>通信 1102~1105, 105 人</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>2013~2014 学年第 1 学期</td> <td>微电子学基础（专业任选）</td> <td>通信 1101~1104, 58 人</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table>	授课时间	课程名称或其它教学任务	授课对象及人数	总学时	2011~2012 学年第 2 学期	电磁场与电磁波（专业主干）	通信 1001~1004, 114 人	56	2012~2013 学年第 1 学期	微电子学基础（专业任选）	通信 0901~0904, 81 人	32	2012~2013 学年第 1 学期	天线与电波传播（专业必修）	通信 0801~0804, 122 人	32	2012~2013 学年第 2 学期	电磁场与电磁波（专业主干）	数理实验班 1001~1004, 7 人	56	2013~2014 学年第 1 学期	电磁场与电磁波（专业主干）	通信 1102~1105, 105 人	56	2013~2014 学年第 1 学期	微电子学基础（专业任选）	通信 1101~1104, 58 人	32			
		授课时间	课程名称或其它教学任务	授课对象及人数	总学时																												
2011~2012 学年第 2 学期	电磁场与电磁波（专业主干）	通信 1001~1004, 114 人	56																														
2012~2013 学年第 1 学期	微电子学基础（专业任选）	通信 0901~0904, 81 人	32																														
2012~2013 学年第 1 学期	天线与电波传播（专业必修）	通信 0801~0804, 122 人	32																														
2012~2013 学年第 2 学期	电磁场与电磁波（专业主干）	数理实验班 1001~1004, 7 人	56																														
2013~2014 学年第 1 学期	电磁场与电磁波（专业主干）	通信 1102~1105, 105 人	56																														
2013~2014 学年第 1 学期	微电子学基础（专业任选）	通信 1101~1104, 58 人	32																														
研究生教学工作量																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>授课时间</th> <th>课程名称或其它教学任务</th> <th>授课对象及人数</th> <th>总学时</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012~2013 学年第 1 学期</td> <td>高等工程电磁场（信号与信息处理、通信与信息系统、电子与通信工程专业）</td> <td>研 1205, 17 人</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>2012~2013 学年第 2 学期</td> <td>专业英语（微电子、通信与信息系统、信号与信息处理专业）</td> <td>研 1205, 研 1214, 22 人</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>2013~2014 学年第 1 学期</td> <td>高等工程电磁场（信号与信息处理、通信与信息系统、电子与通信工程专业）</td> <td>研 1305, 17 人</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table>	授课时间	课程名称或其它教学任务	授课对象及人数	总学时	2012~2013 学年第 1 学期	高等工程电磁场（信号与信息处理、通信与信息系统、电子与通信工程专业）	研 1205, 17 人	32	2012~2013 学年第 2 学期	专业英语（微电子、通信与信息系统、信号与信息处理专业）	研 1205, 研 1214, 22 人	32	2013~2014 学年第 1 学期	高等工程电磁场（信号与信息处理、通信与信息系统、电子与通信工程专业）	研 1305, 17 人	32																	
授课时间	课程名称或其它教学任务	授课对象及人数	总学时																														
2012~2013 学年第 1 学期	高等工程电磁场（信号与信息处理、通信与信息系统、电子与通信工程专业）	研 1205, 17 人	32																														
2012~2013 学年第 2 学期	专业英语（微电子、通信与信息系统、信号与信息处理专业）	研 1205, 研 1214, 22 人	32																														
2013~2014 学年第 1 学期	高等工程电磁场（信号与信息处理、通信与信息系统、电子与通信工程专业）	研 1305, 17 人	32																														
指导本科学生情况																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>时间</th> <th>本科生</th> <th>获奖情况/承担大学生科技创新项目情况</th> <th>毕设</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011 年</td> <td></td> <td></td> <td>10 人, 2 人评为“优”。</td> </tr> <tr> <td>2012 年</td> <td>3 人</td> <td>国家级大创项目一项, 已通过验收。</td> <td>6 人, 1 人评为“优”</td> </tr> <tr> <td>2013 年</td> <td>6 人</td> <td>北京市级大创项目 1 项, 在研。</td> <td>4 人</td> </tr> <tr> <td>2011~2013 年</td> <td>16 人</td> <td>参与自己主持的国家级、北京市级科研纵向项目研究。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	时间	本科生	获奖情况/承担大学生科技创新项目情况	毕设	2011 年			10 人, 2 人评为“优”。	2012 年	3 人	国家级大创项目一项, 已通过验收。	6 人, 1 人评为“优”	2013 年	6 人	北京市级大创项目 1 项, 在研。	4 人	2011~2013 年	16 人	参与自己主持的国家级、北京市级科研纵向项目研究。														
时间	本科生	获奖情况/承担大学生科技创新项目情况	毕设																														
2011 年			10 人, 2 人评为“优”。																														
2012 年	3 人	国家级大创项目一项, 已通过验收。	6 人, 1 人评为“优”																														
2013 年	6 人	北京市级大创项目 1 项, 在研。	4 人																														
2011~2013 年	16 人	参与自己主持的国家级、北京市级科研纵向项目研究。																															

指导研究生情况

时间	研究生	获奖情况	其他
2011 年	1 人		10 人, 2 人评为“优”。
2012 年	3 人	1 人获“校级优秀学生干部”	6 人, 1 人评为“优”
2013 年	4 人	1 人获校级优秀团员, 3 人获校级虚拟仪器竞赛三等奖 (2012)。	4 人

小结: 工作量远远超过岗位要求, 教学效果 2013 年评价为优。已积极承担本科生科研创新、学科竞赛指导工作。

2. 教研、教改项目、课程建设; 教材、教学成果奖励、教研、教改论文 (只写第一作者) 等

主持或参与的教研、教改、教材建设项目

起止年月	项目名称	项目来源	个人经费/总经费	排名
2011.1~2012.12	“电磁场与电磁波”课程学科前沿与教学内容有机结合的研究与实践	校级教改项目	总经费 0.8 万元	1
2012.6~2014.6	电磁场与电磁波	校级教材建设项目	总经费 1 万元	1
2012.1-2013.12	微波技术课程建设	校级课程建设	0.3 万元 (总经费 1 万元)	2
2008.1-2011.12	通信工程专业建设中产学研结合的探索与实践	市级教改项目	0.5 万 (总经费 5.0 万元)	第 6

发表的教改论文

题目	出版单位/刊物名称	年、卷、期、时间	个人排序	收录情况
大学生科研创新在我校应用型人才培养中的重要作用	清华大学教育研究	2012 年增刊	1	中文核心期刊

科 研 工 作	岗位说明书 规定的科研工作 工作任务	聘期内完成情况（可另附页） 项目名称、项目来源、实到经费、排名；论文名称（只写第一作者）、期刊名、发表时间；著作名称、出版社、排名、出版时间；获奖；专利，软件著作权等				
	1、聘期内以第一作者（含本人指导的研究生为第一作者）在国内 外学术刊物发表论文 4 篇（含）以上，其中核 心期刊或进入国际三大检索论文不少于 2 篇； 2、聘期内主持局级(含)以上科研项目或横 向科研项目的工作，或参加省部级(含)以上 科研项目的工作(本人排名在前 3 名之内)， 主持或参与科研项目的支配经费累计达 到 6 万元以上；	1.项目承担情况				
		起止年 月	项目名称	项目来源	个人经费/总经费	排名
		2010.1 ~ 2012.12	嵌入低温共烧陶瓷多层封装基板的微机械太赫兹波导、波导元件及其工艺研究（60976083）	国家自然科学基金（面上项目）	项目总经费：36.00 万元，其中 6.00 万元拨付第二承担单位北京大学。	第 1
		2012.1 ~ 2015.12	系统级封装多层基板中冷却用微管道网络的微制造技术（3102014）	北京市自然科学基金（面上项目）	项目总经费 11.00 万元	第 1
		2012.1 ~ 2015.12	LTCC 微加速度计（61176102）	国家自然科学基金（面上项目）	项目总经费 60.00 万元	第 1
		2012.01 ~ 2015.12	基于××××的三维高密度集成技术基础研究子课题“电磁模型”	国家 973 计划	个人经费：100 万元，其中到款 25.00 万元（项目总经费 2500 万元，我校为子课题承担单位，总经费 100 万元）。	第 1（子课题负责人）
		2012.01 ~ 2015.12	基于××××的三维高密度集成技术基础研究子课题“系统级封装测量”	国家 973 计划	个人经费：100 万元，其中到款 30.00 万元（项目总经费 2500 万元，我校为子课题承担单位，总经费 100 万元）。	第 1（子课题负责人）
		2011.1 ~ 2013.12	三维系统级封装（3D SIP）设计技术基础研究	北京市属高等学校人才强教深化计划“中青年骨干人才培养计划”项目	总经费 12.00 万元	第 1
		2012.01 ~ 2013.08	面向物联网的微系统电互连设计技术	横向，必创公司	总经费 15.00 万元	第 1
		2012.01 ~2013.08	多功能 LTCC 基板微功能结构设计与分析	横向，北京大学	总经费 10.00 万元	第 1
		2011.09 ~ 2012.12	TSV 转接板电特性研究	横向，TSV 技术攻关联合体	总经费 6.00 万元	第 1
		2010.01 ~	基于 MEMS 的微系统技术	横向，北京大学	总经费 10.00 万元	第 1

2011.12				
2011.03 ~ 2011.12	专用多功能 LTCC 基板制造技术	横向, 北京大学	总经费 5.00 万元 个人经费 1.00 万元	第 2
2011.01 ~ 2011.12	多功能 LTCC 基板设计技术开发	横向, 北京大学	总经费 4.90 万元 个人经费 1.00 万元	第 3
2012.01 ~ 2012.12	无线传感器网络技术研究	横向, 必创公司	15.00 万元	第 2

2.论文情况（第一作者）

论文发表情况

题 目	出版单位/刊物名称 年卷期、时间	本人排序	收录检索情况
一种制备硅通孔电镜测试样品的新方法	北京信息科技大学学报, Vol. 26, No. 2, pp. 45-47, Apr. 2011.	第 2 (共 3 名作者) 研究生第一作者	
系统级封装中穿透性硅通孔建模及分析	北京信息科技大学学报, Vol.26, No. 3, Jun. 2011, pp. 15-19	第 1 (共 5 名作者)	
3D Modeling and Electrical Characteristics of Through-Silicon-Via (TSV) in 3D Integrated Circuits	The 12th Electronic Packaging Technology and High Density Packaging (ICEPT-HDP 2011), pp:1-5 pp:1-5, 2011	第 2 (共 6 名作者) 研究生第一作者	EI: 201147145 39888
Design and Simulation of THz Filters Embedded in LTCC Multi-layer Substrate	2011 IEEE International Conference on Electron Devices and Solid-State Circuits, Nov. 2011, Tianjin, China 2011 年 11 月	第 1 (共 6 名作者)	EI: 201204147 17724
TSV 绝缘层完整性在线测试方法研究	测试技术学报 2012 年 12 月	第 1 (共 6 名作者)	EI: 201311161 20272
Research On Microsystem Interposer Designer Software With Through Silicon Via	ICEPT-HDP, 2012 年 8 月: 137-14	第 2 (共 8 名作者) 研究生第一作者。	EI: 201314161 60661
THz Filters Embedded in LTCC Multi-layer	ICEPT-HDP, 2012. 8 2012 年 8 月:	第 2 (共 6 名作者) 研究生第一作者	EI: 201314161 60845

		<table><tr><td>Substrate</td><td>1003-1006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investigation of a Unified LTCC-based Micromachining and Packaging Platform for High Density/Multifunctional Microsystem Integration</td><td>the 62nd Electronic Components and Technology Conference (ECTC) , San Diego, California, USA, May 29 - June 1, 2012, pp. 377-384</td><td>第 1(共 7 名作者)</td><td>EI: 201240155 00801</td></tr><tr><td>Understanding Effect of Additives in Copper Electroplating Filling for Through Silicon Via</td><td>2012 IEEE 11th International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology (ICSICT), Xi'an, China, 29 Oct. - 1 Nov. 2012</td><td>第 1(共 10 名作者)</td><td>EI: 201311161 20272</td></tr><tr><td>60GHz 贴片天线用低温共烧陶瓷基板的微机械加工</td><td>光学精密工程 2013 年 6 月, 第 21 卷第 4 期</td><td>第 1(共 5 名作者)</td><td>核心期刊, EI 收录</td></tr><tr><td>Investigation of Micromachined LTCC Functional Modules for High-density 3D SIP based on LTCC Packaging Platform</td><td>the 63nd Electronic Components and Technology Conference (ECTC) , Las Vegas, Nevada, USA, May 28 - 31, 2013</td><td>第 1(共 10 名作者)</td><td>EI: 201337167 19643</td></tr><tr><td>Software Design On TSV-Based Three-Dimensional Interconnected [C].</td><td>14th International Conference on Electronic Packaging Technology(ICEPT),Dalian, Aug.2013. pp.617-621.</td><td>第 2(共 5 名作者) 研究生第一作者。</td><td></td></tr><tr><td>Hollow TSV VS Solid TSV and Effect of Medium Filling in the Hollow TSV</td><td>14th International Conference on Electronic Packaging Technology(ICEPT),Dalian, Aug.2013. pp.1308-1311.</td><td>第 2(共 4 名作者) 研究生第一作者</td><td></td></tr></table>	Substrate	1003-1006			Investigation of a Unified LTCC-based Micromachining and Packaging Platform for High Density/Multifunctional Microsystem Integration	the 62nd Electronic Components and Technology Conference (ECTC) , San Diego, California, USA, May 29 - June 1, 2012, pp. 377-384	第 1(共 7 名作者)	EI: 201240155 00801	Understanding Effect of Additives in Copper Electroplating Filling for Through Silicon Via	2012 IEEE 11th International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology (ICSICT), Xi'an, China, 29 Oct. - 1 Nov. 2012	第 1(共 10 名作者)	EI: 201311161 20272	60GHz 贴片天线用低温共烧陶瓷基板的微机械加工	光学精密工程 2013 年 6 月, 第 21 卷第 4 期	第 1(共 5 名作者)	核心期刊, EI 收录	Investigation of Micromachined LTCC Functional Modules for High-density 3D SIP based on LTCC Packaging Platform	the 63nd Electronic Components and Technology Conference (ECTC) , Las Vegas, Nevada, USA, May 28 - 31, 2013	第 1(共 10 名作者)	EI: 201337167 19643	Software Design On TSV-Based Three-Dimensional Interconnected [C].	14th International Conference on Electronic Packaging Technology(ICEPT),Dalian, Aug.2013. pp.617-621.	第 2(共 5 名作者) 研究生第一作者。		Hollow TSV VS Solid TSV and Effect of Medium Filling in the Hollow TSV	14th International Conference on Electronic Packaging Technology(ICEPT),Dalian, Aug.2013. pp.1308-1311.	第 2(共 4 名作者) 研究生第一作者	
Substrate	1003-1006																													
Investigation of a Unified LTCC-based Micromachining and Packaging Platform for High Density/Multifunctional Microsystem Integration	the 62nd Electronic Components and Technology Conference (ECTC) , San Diego, California, USA, May 29 - June 1, 2012, pp. 377-384	第 1(共 7 名作者)	EI: 201240155 00801																											
Understanding Effect of Additives in Copper Electroplating Filling for Through Silicon Via	2012 IEEE 11th International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology (ICSICT), Xi'an, China, 29 Oct. - 1 Nov. 2012	第 1(共 10 名作者)	EI: 201311161 20272																											
60GHz 贴片天线用低温共烧陶瓷基板的微机械加工	光学精密工程 2013 年 6 月, 第 21 卷第 4 期	第 1(共 5 名作者)	核心期刊, EI 收录																											
Investigation of Micromachined LTCC Functional Modules for High-density 3D SIP based on LTCC Packaging Platform	the 63nd Electronic Components and Technology Conference (ECTC) , Las Vegas, Nevada, USA, May 28 - 31, 2013	第 1(共 10 名作者)	EI: 201337167 19643																											
Software Design On TSV-Based Three-Dimensional Interconnected [C].	14th International Conference on Electronic Packaging Technology(ICEPT),Dalian, Aug.2013. pp.617-621.	第 2(共 5 名作者) 研究生第一作者。																												
Hollow TSV VS Solid TSV and Effect of Medium Filling in the Hollow TSV	14th International Conference on Electronic Packaging Technology(ICEPT),Dalian, Aug.2013. pp.1308-1311.	第 2(共 4 名作者) 研究生第一作者																												
3. 著作情况		著作情况																												
<table><tr><td>著作名称</td><td>出版单位/出版时间</td><td>刊号</td><td>本人承担 (万字)</td></tr><tr><td>微米纳米器件封装技术</td><td>国防工业出版社, 2012.10。</td><td>ISBN 978—7—118—07896—1</td><td>封面第三作者, 本人</td></tr></table>		著作名称	出版单位/出版时间	刊号	本人承担 (万字)	微米纳米器件封装技术	国防工业出版社, 2012.10。	ISBN 978—7—118—07896—1	封面第三作者, 本人																					
著作名称	出版单位/出版时间	刊号	本人承担 (万字)																											
微米纳米器件封装技术	国防工业出版社, 2012.10。	ISBN 978—7—118—07896—1	封面第三作者, 本人																											

				获得国家最高级别的出版基金“国家科学技术学术著作出版基金”资助		撰写第 5 章，计 65600 字（全书 305000 字），并审核全书。																	
			三维集成电路设计	机械工业出版社，2013.09	ISBN: 978-7-111-43351-4，2013.09	本人为封面第一译者，翻译序言、第 1、2、4 章，计 6.9 万字，审校全书。																	
			4.专利与软件著作权																				
			专利与软件著作权																				
			<table><tr><th>时间</th><th>专利名称</th><th>专利号或授权号</th><th>授予国别</th><th>排名</th></tr><tr><td>2013.04.03</td><td>微机械太赫兹波导、太赫兹波导式谐振腔及制备方法</td><td>ZL200910087333.1</td><td>中国发明专利</td><td>1</td></tr><tr><td>2011.04.06</td><td>微机械可调微波带通滤波器</td><td>ZL200710303767.1</td><td>中国发明专利</td><td>1</td></tr><tr><td>2012.11.21</td><td>一种可调微波带通滤波器</td><td>ZL200910087815.7</td><td>中国发明专利</td><td>1</td></tr></table>				时间	专利名称	专利号或授权号	授予国别	排名	2013.04.03	微机械太赫兹波导、太赫兹波导式谐振腔及制备方法	ZL200910087333.1	中国发明专利	1	2011.04.06	微机械可调微波带通滤波器	ZL200710303767.1	中国发明专利	1	2012.11.21	一种可调微波带通滤波器
时间	专利名称	专利号或授权号	授予国别	排名																			
2013.04.03	微机械太赫兹波导、太赫兹波导式谐振腔及制备方法	ZL200910087333.1	中国发明专利	1																			
2011.04.06	微机械可调微波带通滤波器	ZL200710303767.1	中国发明专利	1																			
2012.11.21	一种可调微波带通滤波器	ZL200910087815.7	中国发明专利	1																			
学科专业建设情况	1. 学科建设: 在学科建设方面, 积极开拓本学科新的研究领域, 目前所在信息微系统、微/纳米微波新器件、先进封装/高速信号完整性等方面开展了研究, 获得多项国家级（5 项）、省部级（3 项）和司局级项目（1 项）资助, 并取得一批成果, 指导硕士生 1 名。创建校属科研机构信息微系统研究所并任所长, 建设一只由 4 名高学历中青年和本校、北京大学的博士、硕士研究生组成的高效率研究团队。积极参与学科发展规划、学科点建设和博士点申报, 近期完成的学科申报是“智慧感知”二级学科。因科研和学科建设成绩突出, 被通信学院评为 2013 年度“科研先进个人”。 2. 专业和实验室建设: 所在通信工程专业为北京市重点建设专业和品牌建设专业, 作为骨干教师, 本人积极参与了专业规划发展的指定、调研、论证, 参与本科生培养计划的讨论和指定。参与电磁场与微波技术实验室的建设, 负责设备调研、采购、安装, 实验的设计与开设等。专业建设具体工作包括: 1) 作为骨干承担国家级专业改革建设任务一项“2012 年教育部卓越计划建设专业（通信工程）”; 2) 承担省部级专业改革建设任务一项“年通信工程北京市特色专业建设”（2008~2012); 3) 校级教学团队建设任务一项（2007~2012）。实验室和实训、实践基地建设方面作为骨干承担的具体工作包括: 1) 国家级工程实践教育中心建设校方（2012 年, 主持人许晓革); 2) 省部级校外实习基地建设校方（2010~2012, 主持人许晓革)。 3. 课程建设: 主讲专业主干课“电磁场与电磁波”的教学, 并作为该课程负责人, 组建																						

	由 4 名讲授该课程的老师组成的课程教学团队，该课程为本专业重点建设课程，涉及抽象物理概念和大量数学工具，其教与学难度都很大。在课程建设中，注意借鉴不同版本教材，丰富讲义内容，制作讲解详细的课件，方便学生自学；通过教学实践，努力让教学方式过渡到启发式教学，调动学生建构知识架构的积极性和创新精神；在教学中注意增加相应内容的工程应用背景，加深学生印象，增强学习的自觉性，学生对学习的兴趣得到提高。努力借助现代教育技术手段，用形象的演示素材，方便学生的学习与记忆，并激发其学习的兴趣。另外，积极参与微波工程、微波通信电路的课程建设、实验平台建设，主持和参加了相应的教改项目各一项。 4. 教材建设：目前正在开展面向卓越计划的、具有全新组织架构的主干课程“电磁场与电磁波”教材和课外辅导材料编写工作，相应工作得到学校第一批教材建设项目（2012）资助，本人担任负责人，组织了电磁场与电磁波类课程教学团队暨教材编写团队。另外，切合学生实际的题库已经初步建成。
指导 学生 和青年 教师 情况	1. 指导青年教师情况. 吸收本专业教研室的 3 名青年教师作为骨干参与自己的科研团队，指导其参与国家级和省部级项目，帮助其提高科研技能、学术水平，并通过各种渠道帮助他们争取科研经费，目前他们的平均年科研到账达到了 10 万元以上。 在教学方面与青年教师定期开展研讨，围绕自己为负责人的主干课课程建设工作，传授教学方面的体会，并通过请青年教师担任助教的方式来帮助他们提高教学水平。担任支部书记以来，定期与青年教师谈话，倾听其诉求，帮助他们迅速结合学校实际建立自己的职业发展规划；为每名 35 岁以下的青年教师安排一名成长导师，指导其教学科研发展。注意安排支部中的青年教师参与支部管理工作，促进其思想和理论、管理水平的提升。 作为青年教师导师指导新引进青年教师一名。 2. 指导学生情况 聘期内每年度指导毕业设计学生平均在 7 人以上，其中三人毕设论文被评为优秀。 在本科生科技创新活动方面，自己注意通过指导电子竞技参赛队和吸收、指导 5 名以上的本科生参与自己负责的前沿性纵向国家级、省部级科研项目以及各种社会实践等形式，来提高其综合素质，目前已有 4 名本科生在本人承担的纵向科研项目中作出了实质性贡献，并取得了发明专利、论文等成果。 在大学生科技创新项目方面，目前还指导了 2 组学生，分别获得国家级和北京市级项目资助。 在指导研究生过程中，注意在生活上关心他们，解决他们的后顾之忧；在思想上循循善诱，引导他们树立远大的理想和良好的道德意志品质；在学业上严格要求，用高水平科研项目锤炼他们，鼓励他们发表高水平论文和参加学科竞赛。有 3 名研究生获得校级“嵌入式应用大赛（2012）”三等奖，一人获校级“优秀学生干部”（2012）。

学术公益	2008 年 9 月起受聘为北京大学微米/纳米加工技术国家级重点实验室的客座副教授，参与其国家级和省部级重大科研项目，并从事研究生指导与课程教学工作，还与之开展了广泛的合作研究。（详情见来自该机构的证明材料，如聘书等） 2008 年 8 月起代表北京大学和我校参加香港应用科学技术研究院主办的先进技术联盟（APTC），参与多次学术讲座交流，2012 年 11 月起，受邀参加每年的产业发展高端研讨会（仅邀请由 20 位来自封装龙头企业、国家级研究院所的高管和高校研发团队负责人参加），并发表主题报告。 2006 年 1 月至今任中国微米/纳米技术学会高级会员，积极参与组织各年度的微米/纳米技术年会等学术交流活动。 2008 年 1 月至今每年参与 IEEE NEMS, ICEPT—HDP 等学术会议的组织，并担任学会分会主席等职务。 2011 年 9 月开始担任“IEEE CPCW”系列研讨会的技术委员会成员，并赴美国参与组织两届会议。 2010 年 7 月至今担任我校学报自然科学版的论文审稿人。 2012 年 3 月至今担任信息与通信工程学院学术委员会成员。 2007 年至今担任国家自然科学基金通信评审专家。 2008 年至今担任总装备部预研基金和重点实验室基金通信评审专家。 - 黑龙江省自然科学基金通信评审专家； - 中关村东升科技园专家库成员。 - 半导体学报（EI 核心期刊）审稿人 - IEEE 会员，会员号：92658027，CPMT 和 Communication Society 等分会会员。 - 美国 International Microelectronics And Packaging Society（IMAPS 学会）的 The Microelectronics Journal of Microelectronics and Electronic Packaging 期刊审稿人。 - 北京物联网研究会会员。
奖惩情况	2013 年获得信息与通信工程学院“科研先进个人”称号。
院聘委会考核意见	聘期考核等次： 负责人签字：_____（公章） 年 月 日

校聘委员会意见	聘期考核等次： (公章) 年 月 日
学校审核意见	 (公章) 年 月 日
本人签字	我已知晓本人的年度考核结果和聘期考核结果。 签字： 年 月 日

填表说明：
1、此表是归档材料，最后本人签字处请手写姓名；
2、请用 A4 纸双面打印。